



DKZ/54/2011

Warszawa, dnia 10.06.2011r.

Podstawa prawna

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami).

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:
dostawę urządzenia do montażu mikrosystemów (die bonder)**

słownik CPV 31700000-3

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej: 193 000,00 EUR.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Instytut Technologii Elektronowej
02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46

adres internetowy: <http://www.ite.waw.pl>

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ww. ustawy.

Oferty złożone w postępowaniu zostaną otwarte i ocenione przez Komisję Przetargową zgodnie z kryterium oceny ofert.

Spośród wszystkich, nie podlegających odrzuceniu ofert zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg kryterium oceny ofert.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego urządzenia do montażu mikrosystemów (die bonder), zwanego dalej „urządzeniem” wraz z instalacją, uruchomieniem i testowaniem.

Wymagania i parametry techniczne przedmiotu zamówienia przedstawione są w załączniku nr 1 do siwz.

4. Składanie ofert częściowych i wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia - maksymalnie do 14 tygodni od daty podpisania umowy.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 7 siwz.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- 7.1 Oświadczenie, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, [załącznik nr 2 do siwz];
- 7.2 Wykaz dostaw – wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 dostawy urządzeń do montażu mikrosystemów die bonder z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie.

Zamawiający zaleca wypełnienie załącznika nr 3 do siwz.

Brak złożenia któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów skutkować będzie wykluczeniem oferenta z postępowania.

8. Inne dokumenty wymagane od wykonawcy:

W przypadku przewidywanego podwykonawstwa, zamawiający żąda wskazania w ofercie tych części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. Brak złożenia informacji w przedmiocie podwykonawstwa uznaje się za zamiar wykonania zamówienia przez Wykonawcę samodzielnie.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Oświadczenia i wnioski mogą być przekazywane wyłącznie drogą pisemną, natomiast wszelkie zawiadomienia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest mgr Michał Urbański e-mail urbanski@ite.waw.pl

Pisemną korespondencję do zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Instytut Technologii Elektronowej
Al. Lotników 32/46,
02-668 Warszawa.
Zespół Zamówień Publicznych
Budynek VI, pokój nr 216.

Fax: + 48 22 548 78 46

10. Wymagania dotyczące wadium: nie wymagamy.

11. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi : 30 dni od daty składania ofert.

12. Opis sposobu przygotowania ofert:

Ofertę należy złożyć na piśmie.

Oferta musi zawierać:

- a) dokładną nazwę i adres oferenta,
- b) datę sporządzenia oferty,
- c) wypełniony załącznik nr 1 do siwz,
- d) cenę netto w PLN (dopuszcza się podanie ceny w EUR, USD lub GBP. W przypadku złożenia ofert w EUR, USD lub GBP dla porównania cen ofert zastosowany zostanie przelicznik na złote polskie – PLN. Przelicznik ten będzie zgodny z kursem sprzedaży walut NBP jaki będzie obowiązywał w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert).

Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.

Wraz z ofertą wykonawca składa dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienione w punkcie 7 niniejszej siwz.

Zamawiający zaleca wypełnienie FORMULARZA OFERTOWEGO - załącznik nr 4 do siwz.

W przypadku udziału w postępowaniu firm spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się złożenie oferty, a także dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w punkcie 7 niniejszej specyfikacji w języku polskim lub w języku angielskim.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia **28.06.2011r.** do godziny **10:00** (w dni robocze w godz. 9:00÷14:00) w siedzibie zamawiającego w Warszawie, Al. Lotników 32/46, bud VI pokój nr 216. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.06.2011r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego w Warszawie, Al. Lotników 32/46 w budynku VI pokój nr 216.

Ofertę należy złożyć w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia opakowania (np. w zaklejonej kopercie). Na kopercie lub opakowaniu powinna być umieszczona nazwa i adres firmy składającej ofertę, a także powinien znajdować się napis: Instytut Technologii Elektronowej, Al. Lotników 32/46, 02 – 668 Warszawa. Budynek VI, pokój 216. Oferta w przetargu nieograniczonym na „dostawę urządzenia do montażu mikrosystemów (die bonder)” – nie otwierać do dnia 28.06.2011r. do godz. 10:15.

14. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena netto podana w PLN (EUR, USD lub GBP) musi obejmować:

- a) urządzenie zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do siwz,
- b) instalację,
- c) uruchomienie,
- d) testowanie,
- e) transport, rozładunek i posadowienie,

17.2 Gwarancja:

- 1) Dostawca gwarantuje prawidłowe działanie i jakość techniczną dostarczonego przedmiotu umowy w ciągu (okres gwarancji w ofercie) miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego, lecz nie dłużej niż (okres gwarancji w ofercie) + 3 miesiące od daty dostawy.
- 2) Dostawca w ramach gwarancji pokrywa koszty naprawy lub wymiany wadliwego towaru, jak również pokrywa koszty związane z jego transportem.
- 3) W okresie gwarancji, w przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Kupującego, Dostawca ma obowiązek zrealizować naprawę lub wymianę nie później niż w okresie 7 tygodni od daty pisemnego zgłoszenia usterek.
- 4) Gwarancja zostanie przedłużona o czas ewentualnej naprawy przedmiotu umowy.
- 5) Wymienione lub naprawione części zostaną objęte gwarancją Dostawcy lub Producenta.
- 6) W okresie gwarancji, Dostawca gwarantuje czas reakcji serwisu maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia usterek.

17.3 Instrukcja dostawy:

- 1) Przedmiot umowy będzie wysłany na poniższy adres i pozostawiony do dyspozycji Kupującego.

Adres dostawy: Instytut Technologii Elektronowej
 Al. Lotników 32/46
 02-668 Warszawa

- 2) Dostawca zawiadomi Kupującego faksem o wysyłce (Nr +48 22 54-87-803).
- 3) Dostawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy deklarację zgodności CE urządzenia.

17.4 Warunki płatności:

Płatność zostanie dokonana w następujący sposób:

- 1) 80% wartości umowy – (wartość z oferty) – płatne przekazem bankowym na podstawie oryginału faktury i dokumentów przewozowych na konto Dostawcy w ciągu 14 dni od daty wysłania przedmiotu umowy.
- 2) 20% wartości umowy – (wartość z oferty) – płatne przekazem bankowym na podstawie oryginału faktury na konto Dostawcy w ciągu 14 dni od daty podpisania przez obie strony Umowy protokołu odbioru.

Kupujący zapłaci Dostawcy przekazem bankowym kwotę za przedmiot umowy na konto Dostawcy w:

.....

Koszty bankowe na terenie Polski ponosi Kupujący, a poza jej granicami – Dostawca.

17.5 Odbiór przedmiotu umowy:

Uruchomienie urządzenia obejmuje rozruch techniczny oraz wykonanie testów funkcjonalnych potwierdzających jego parametry techniczne zgodnie ze specyfikacją techniczną i wymaganiami określonymi w siwz. Potwierdzenie odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi poprzez podpisanie przez obie strony protokołu odbioru.

17.6 Siła wyższa:

1. W przypadku działania siły wyższej strony Umowy są zwolnione od odpowiedzialności za nie wywiązanie się ze swoich zobowiązań lub zobowiązania te będą zmienione, zgodnie z zapisem punktu 4. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wszystkie wydarzenia, nie dające się przewidzieć przez żadną ze stron w dniu podpisania Umowy i występujących po tej dacie, nie dających się uniknąć i pozostających poza kontrolą obydwu stron.

- Przypadkami siły wyższej są np. wypadki, powódź, trzęsienie ziemi, pożar, wybuch, wojna, mobilizacja, strajki, blokady, generalny brak środków transportu, materiałów lub siły roboczej.
- Strona Umowy chcąc zgłosić roszczenia wynikające z siły wyższej ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą stronę o jej wystąpieniu i zakończeniu.
- Strona zgłaszająca roszczenia musi udowodnić drugiej stronie wystąpienie siły wyższej przy pomocy dokumentów wydanych przez odpowiednie, uprawnione do tego władze w swoim kraju. Daty i terminy wypełnienia zobowiązań zostaną przełożone lub przedłużone o okres, w którym zaistniała siła wyższa.

17.7 Rozstrzygnięcie sporów:

Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, których nie da się wyjaśnić polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z regulaminem tego Sądu.

18. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy: nie wymagamy.

19. Tryb udzielania wyjaśnień na temat siwz:

W terminie do dnia 20.06.2011r. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną. Zamawiający odpowie na wszystkie zapytania, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. Zamawiający zamieści treść pytań i odpowiedzi na swojej stronie internetowej.

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (dostęp do powyższych informacji - strona internetowa www.uzp.gov.pl).

21. Inne:

Do spraw nieuregulowanych w siwz mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych i Technicznych

mgr Michał Urbański

Zamówienie jest finansowane ze środków wspólnotowych: zakup jest finansowany z projektu nr POIG 02.01.00-14-081/09 pt. Mikrosystemy i NanoTechnologie Elektroniczne dla Innowacyjnej Gospodarki „MINTE”

Wymagania i parametry techniczne urządzenia do montażu mikrosystemów (die bonder)

Lp.	Nazwa parametru	Wymaganie	Kolumna do wypełnienia przez oferenta *
1	2	3	4
1.	Typ urządzenia		podać
2.	Rok produkcji	2011	potwierdzić
3.	Kraj producenta urządzenia		podać
4.	Producent urządzenia		podać
5.	Urządzenie	Fabrycznie nowe, nie używane w jakimkolwiek laboratorium oraz nie pokazywane na konferencjach i imprezach targowych.	potwierdzić
6.	Wymagania ogólne	Nabiurkowe urządzenie przeznaczone do programowalnego, kontrolowanego i powtarzalnego wykonywania operacji przenoszenia, klejenia, lutowania, wspomaganego ultradźwiękami termokompresyjnego łączenia struktur/komponentów, detektorów półprzewodnikowych itp. do podłoża. Dokładność układania 5 µm lub wyższa. Sterowanie: PC z systemem XP Pro lub Win 7 Pro	potwierdzić
7.	Rodzaje procesów	Klejenie struktur z nakładaniem kleju metodą stemplowania lub dozownika. Lutowanie struktur na grzonym stoliku z dogrzewaniem strumieniem gorącego gazu Łączenie termokompresyjne struktur do podłoża, wspomagane ultradźwiękami – FLIPCHIP Przenoszenie struktur (PICK AND PLACE) z pociętej płytki min. 6 cali na folii do pojemników GelPack, WafflePack	potwierdzić
8.	Parametry urządzenia	Urządzenie wyposażone w osprzęt pozwalający na wyjmowanie, przenoszenie i umieszczanie na materiale podłożowym komponentów o różnych rozmiarach. Minimalne wymiary komponentów: 150x150 µm, maksymalne wymiary komponentów: 40mmx40mm. Maksymalne wymiary podłoża: 200mmx300mm	potwierdzić
		Dokładność X-Y klejenia (PICK AND PLACE) lepsza niż 5 µm Dokładność X-Y Flip-Chip lepsza niż 3 µm	potwierdzić i podać
		Rozdzielczość przesuwu stolika: min. 0,3µm.	potwierdzić i podać

9.	Sposób podawania kleju	Z dozownika pozwalającego na regulowanie objętości kropli kleju (regulacja za pomocą ciśnienia i czasu). Komputerowe sterowanie głowicą dozującą, z dedykowanym oprogramowaniem opartym na systemie Windows, (XP Pro lub 7 Pro)	potwierdzić i podać
		Metodą stemplowania, napęd pneumatyczny	potwierdzić
10.	Stolik do lutowania	Minimalna temperatura dla pracy ciągłej: 300°C, stosowanie atmosfery ochronnej	potwierdzić i podać
		Mocowania próbek za pomocą próżni	potwierdzić
		Maksymalny wymiar próbek dających się zamocować na stoliku: 50x50 mm	potwierdzić
		Regulacja wysokości położenia stolika w zakresie co najmniej 10mm	potwierdzić
11.	Stolik do pudełek typu Wafflepack, GelPack 4x4 cale	Przystawka do pudełek typu „Wafflepack” 4”x4”	potwierdzić
		Ręczne pozycjonowanie w kierunkach X-Y Pozycjonowanie Theta (kąt obrotu)	potwierdzić i podać
		Regulacja wysokości położenia stolika w zakresie co najmniej 10mm	potwierdzić i podać
12.	Stolik do pociętych na folii płytek o średnicy min. 6 cali	Maksymalna średnica płytki: 6”	potwierdzić i podać
		Wypychanie struktur za pomocą pojedynczej igły w przypadku małych struktur lub kilku igieł w przypadku dużych struktur	potwierdzić i podać
13.	Urządzenie umożliwiające zwiększanie siły połączenia	Zwiększa siłę nacisku do 50N	potwierdzić i podać
14.	Grzanie strumieniem gorącego gazu	Dysza do podgrzewania małych komponentów. Średnica dyszy do 10mm.	potwierdzić
		Temperatura do 500°C	potwierdzić i podać
15.	Generator ultradźwięków	Generator ultradźwiękowy PLL, przetwornik ultradźwiękowy	potwierdzić
16.	Głowica do stemplowania	Zapewnione.	potwierdzić
17.	Kamera umożliwiająca podgląd boczny. Powiększenie 280x lub więcej	Zapewnione.	potwierdzić i podać
18.	Oświetlenie	Oświetlacz LED pierścieniowy, mocowany niezależnie	potwierdzić
		Oświetlenie współosiowe	potwierdzić
		Źródło światła mocowane na elastycznym ramieniu	potwierdzić
19.	Sposób sterowania	Sterowanie ręczne poprzez panel sterujący oraz joystick. Ręczne ustalanie położenia stolika roboczego	potwierdzić

20.	<p>Dwuetapowy test akceptacyjny: a) Wstępny test akceptacyjny w siedzibie Wykonawcy b) Końcowy test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego</p>	<p>A - Wykonanie testów na standardowych strukturach i podłożach stosowanych przez wykonawcę urządzenia. Wykonanie klejenia i lutowania struktur na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obudowach metalowych i ceramicznych - podłożach z metalizowanego laminatu (FR4) <p>Sprawdzenie automatycznej kontroli i pomiaru temperatury.</p> <p>Sprawdzenie dokładności położenia struktur na podłożu/obudowie.</p> <p>Wykonywanie co najmniej 10 klejeń i lutowań w każdym z wymienionych wyżej przypadków.</p> <p>B - Wykonanie, w miejscu instalacji, testów klejenia:</p> <p>struktur krzemowych 14,0x14,0 mm na metalizowanym podłożu FR4 o średnicy 24mm</p> <p>struktur o wymiarach 11,3x11,3 na podłożu ceramicznym o wymiarach 11,4x17,0 mm, truktury</p> <p>diod LED o wymiarach 0,25x0,25mm na metalizowanym laminacie FR4</p> <p>Sprawdzenie dokładności położenia struktur na podłożu/obudowie. Wykonywanie co najmniej 10 klejeń w każdym z wymienionych wyżej przypadków</p>	potwierdzić
21.	Termin realizacji przedmiotu zamówienia	Maksymalnie do 14 tygodni od daty podpisania umowy.	potwierdzić i podać
22.	Szkolenie trzech osób w siedzibie Zamawiającego	Zapewnione.	potwierdzić
23.	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim lub angielskim	Zapewnione.	potwierdzić i podać
24.	Dostępność części zamiennych - 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru	Zapewnione.	potwierdzić
25.	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru	Zapewnione.	potwierdzić
26.	Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru	Zapewnione.	potwierdzić
27.	Okres gwarancji minimalnie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru	Zapewnione.	podać

* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.

.....
pieczęć adresowa Wykonawcy

.....
data

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu.

.....
podpis osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

.....
pieczęć adresowa wykonawcy

.....
data

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzenia do montażu mikrosystemów (die bonder) oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy następujące dostawy:

Lp.	Przedmiot dostawy	Wartość dostawy	Data wykonania dostawy	Odbiorca dostawy
1	2	3	4	5
1.				
2.				

Uwaga! Do każdej przedstawionej w tabeli wykonanej dostawy należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

.....
podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

.....
pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

dla Instytutu Technologii Elektronowej

Przedmiot zamówienia		Dostawa urządzenia do montażu mikrosystemów (die bonder).
1.	Nazwa i adres Wykonawcy	
2.	NIP	
3.	Telefon: Fax: e-mail:	
4.	Cena oferty netto PLN (EUR/ USD/ GBP) słownie:..... Stawka podatku VAT%
5.	Termin wykonania zamówienia: do 14 tygodni od daty podpisania umowy	Podać w tygodniach:
6.	Osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy	
7.	Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzenia do montażu mikrosystemów (die bonder) oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z siwz.	
8.	Dokumenty załączone do oferty	1. . .
9.	Miejscowość Data sporządzenia oferty	

.....
podpis osoby /osób uprawnionej /uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy